

NEW PRODUCT NEWS

T-CLAMP ULTRA



피삭재 소재별로 특화된 신규 칩브레이커 출시



KEY POINT

대구텍은 티클램프 제품군에서, 피삭재 소재별로 더욱 특화된 신규 칩브레이커 인서트를 출시합니다.

신규로 출시되는 칩브레이커 인서트는 **TDUF**와 **TDV** 타입입니다.

TDUF 인서트는 특수 형상의 칩브레이커로 인하여 크롬-니켈 합금강 및 저탄소강 가공에 적합하며, 특히 베어링강 가공에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 또한 저이송 영역에서 칩 컨트롤이 탁월합니다.

TDV 인서트는 날카로운 절삭 인선과 넓은 칩 그루브로 인하여 가공 부하 발생이 적고, 스테인리스강 및 연강 가공에서 우수한 성능을 발휘하며 칩 분절력이 우수하고 구성인선의 발생을 방지합니다.

특히 관 및 작은 지름 등의 소형 소재를 중-저 이송 영역에서 가공할 때 가공 수명이 우수합니다. 또한 가공 후 편평한 바닥면을 구현합니다.

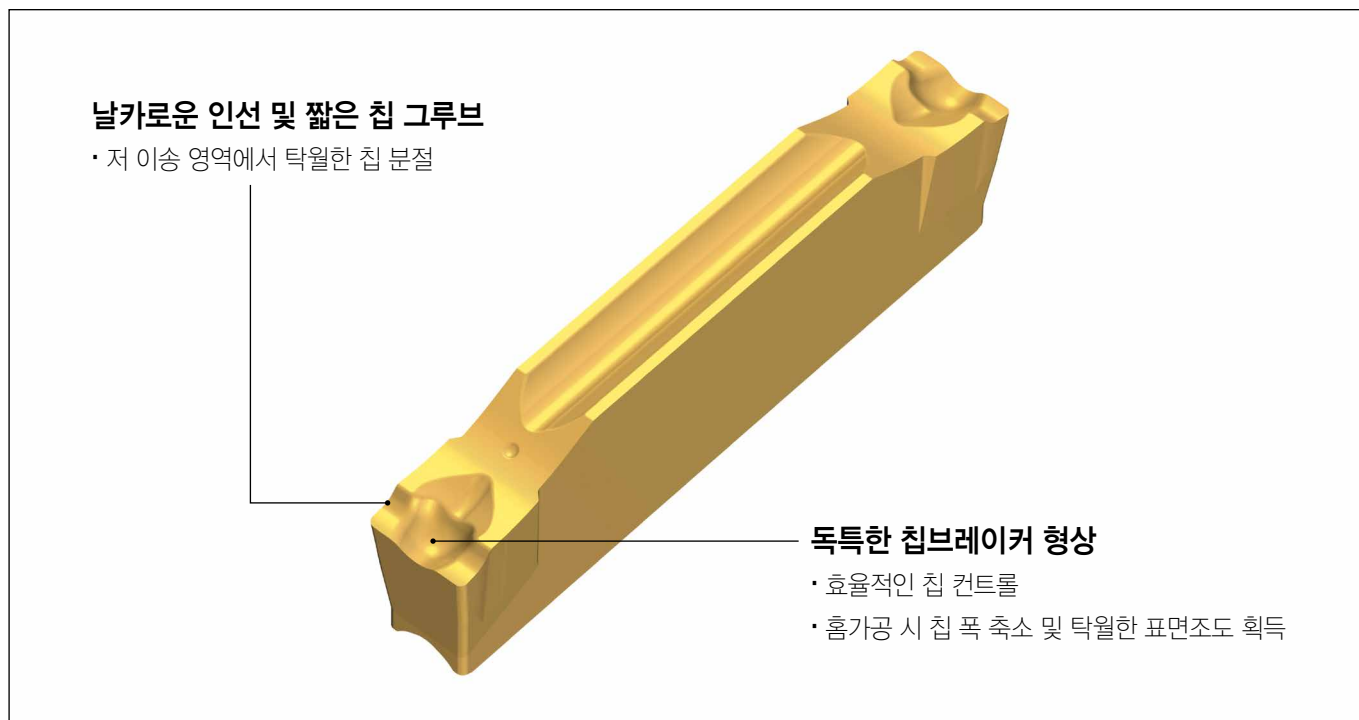
TDUF 인서트의 특징

- 크롬-니켈 합금강 및 저탄소강 가공에 적합
- 베어링강 가공에서 특히 탁월한 성능 발휘
- 저이송 영역에서 적용
- 칩 컨트롤 탁월함

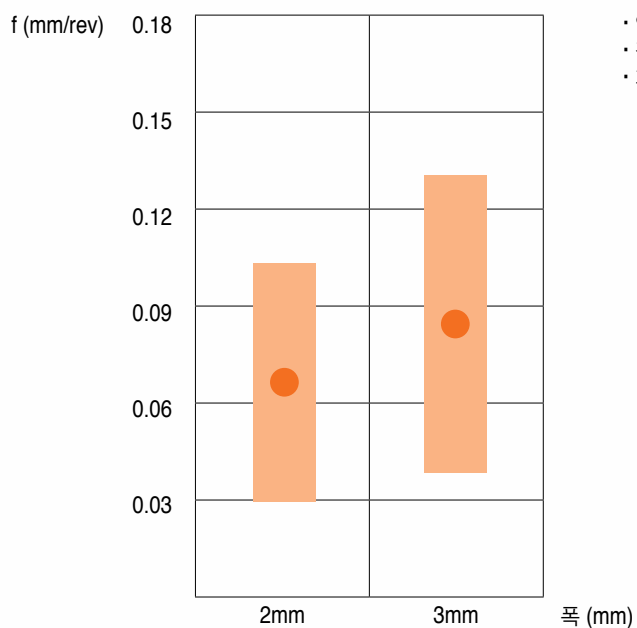
TDV 인서트의 특징

- 날카로운 절삭 인선과 넓은 칩 그루브로 낮은 가공 부하 발생
- 우수한 칩 분절력 및 구성인선 방지
- 스테인리스강 및 연강 가공에서 우수한 성능 발휘
- 관(tube) 및 작은 지름의 소재에 중-저 이송 영역에서 적용
- 소형 소재의 가공에 적합
- 편평한 바닥면 구현 가능

TDUF 인서트






TDUF 인서트 추천 이송영역



- 인서트 : TDUF
- 절삭속도 (V) : 120 m/min
- 피삭재 : SUJ 2 (HB 150~180)

TDUF 칩 분절력 및 표면 조도 비교 테스트 1

베어링강(SUJ 2), 속도=120 m/min

feed (mm/rev)	TDUF 2		경쟁사 A		경쟁사 B	
	0.03	0.05	0.03	0.05	0.03	0.05
칩						
표면	feed=0.03(mm/rev) 		feed=0.03(mm/rev) 		feed=0.03(mm/rev) 	

TDUF 칩 분절력 비교 테스트 2

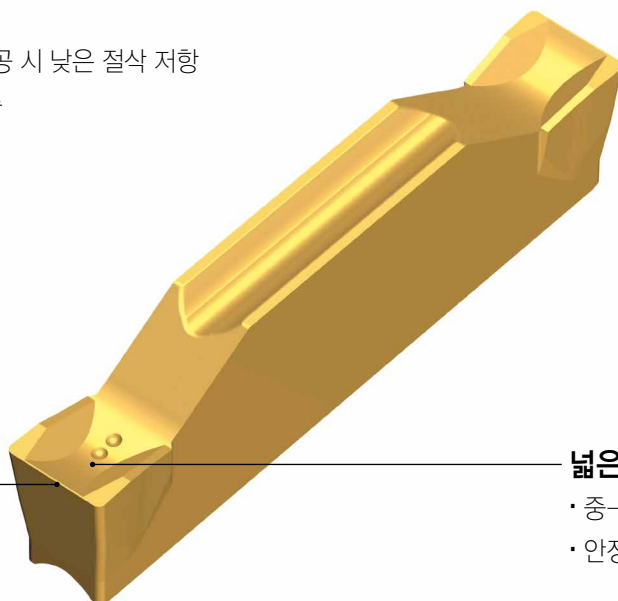
저탄소강(S20C), 속도=150 m/min

feed (mm/rev)	TDUF 2			경쟁사 A			경쟁사 B		
	0.03	0.05	0.08	0.03	0.05	0.08	0.03	0.05	0.08
칩									

TDV 인서트

날카로운 인선

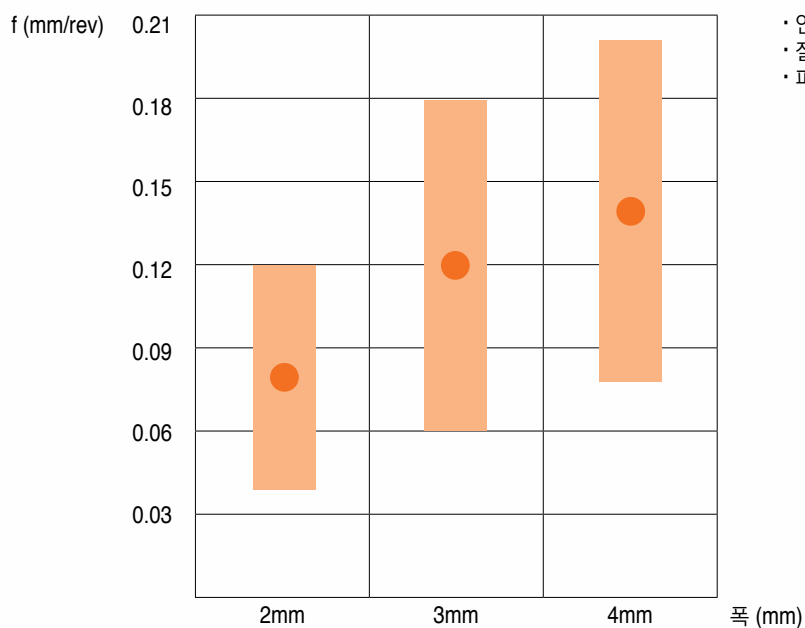
- 관(tube) 및 소형 소재 가공 시 낮은 절삭 저항
- 버(burr) 및 표면 조도 우수



넓은 칩 그루브

- 중-저 이송영역에 가능
- 안정적인 칩 형성

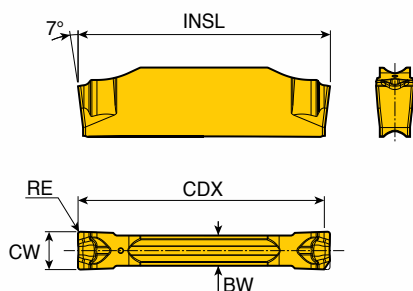
TDV 인서트 추천 이송영역



- 인서트 : TDV
- 절삭속도 (V) : 100 m/min
- 피삭재 : SUS 304 (HB 150~180)

TDUF

UF타입 형상의 절단 및 흡가공용 양날 인서트



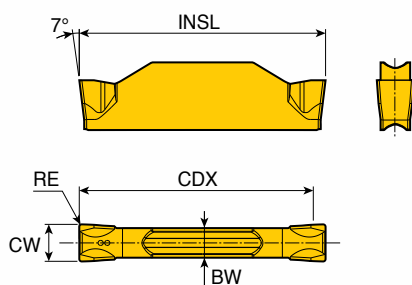
규격	치수 (mm)				
	CW	RE	BW	INSL	CDX
2	2	0.2	1.5	20	19
3	3	0.2	2.4	20	19

인서트	규격	인서트 시트 사이즈	이송 (mm/rev)	코팅	
				TT9080	
	TDUF 2	2	0.03-0.11	●	
	3	3	0.04-0.13	●	

●: 표준 제품

TDV

V타입 형상의 절단 및 흡가공용 양날 인서트



규격	치수 (mm)				
	CW	RE	BW	INSL	CDX
2	2	0.2	1.7	20	19
3	3	0.2	2.4	20	19
4	4	0.3	3.0	20	19

인서트	규격	인서트 시트 사이즈	이송 (mm/rev)	코팅	
				TT9080	TT8020
	TDV 2	2	0.04-0.12	●	●
	3	3	0.06-0.18	●	●
	4	4	0.08-0.20	●	●

●: 표준 제품